

聚辰半导体股份有限公司

2025 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 117,757.04 万元。为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，在关注公司自身投资价值的基础上，进一步增强投资者回报水平，结合公司目前整体经营情况及公司发展阶段，经第三届董事会第十四次会议决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 158,271,044 股测算，本次利润分配预计分配现金红利 11,078.97 万元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.47%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/股权激励授予股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年年度利润分配方案未涉及可能被实施其他风险警示的情形，公司最近三个会计年度的相关现金分红指标如下表所示：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	110,789,730.80	47,434,745.70	31,468,338.20
回购注销总额（元）	0.00	81,817,427.66	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	363,576,041.92	290,269,536.29	100,357,931.43
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,177,570,362.21		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	189,692,814.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	81,817,427.66		
最近三个会计年度平均净利润（元）	251,401,169.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	271,510,242.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 3,000 万元	否		
现金分红比例（%）	108.00		
现金分红比例是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	544,231,461.84		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	2,953,037,653.66		

最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	18.43
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15%以上	是
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

2026 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《聚辰股份 2025 年年度利润分配方案》，决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金红利总额。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案兼顾了公司的可持续性发展以及对投资者的合理回报，不会对公司的生产经营等产生实质性影响。

（二）本次利润分配方案尚需公司股东会批准方可实施，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日